

2023年度

国際交流促進への助成応募要領

電子回路基板技術に関する基礎技術、応用技術及び生産技術の国際交流促進への助成応募は、本要領によって行われますので「申請される方への注意」と合わせて充分お含みのうえ、所定の申請書に正確に記載してください。

1. 助成の対象領域

電子回路基板技術に関する基礎技術、応用技術及び生産技術の国際交流の促進に貢献することが期待され得る次のものを対象とします。

- (1) 海外で開催される研究発表会、シンポジウム等への出席その他海外への出張等
- (2) 海外の研究者・技術者の国内への招聘

なお、海外で開催する国際研究発表会、国際シンポジウム等への助成は、「研究発表会・シンポジウム等への助成」対象となりますので同応募要領にしたがってください。

2. 応募の資格

応募資格者は、次の機関・団体等、または同機関・団体等に所属する常勤の研究者・技術者等とします。

- (1) 大学及び高等専門学校
- (2) 国公立等の研究機関
- (3) その他本財団で認めた機関・団体等

3. 助成の金額

20万円を上限とし、出張先地域等その内容によって決定します。この助成金は、渡航旅費等指定費目以外に使用することはできません。

4. 出張、招聘等の時期

助成の対象となる研究発表会・シンポジウム等への出席その他海外への出張等及び海外の研究者・技術者の国内への招聘は、原則として次の期間内に行われるものとします。

2024年4月1日から2025年3月31日までの1年間

5. 助成対象者の選定

助成対象者の選定は選考委員会における厳正な審査を経てその採否を決定し、2024年2月下旬までに申請者宛に採否通知します。

なお、採択後、申請時と異なる事態を生じた場合は、採択が取り消されることもありますので充分注意してください。

6. 海外出張等の終了報告

海外で行われる研究発表会等から日本への帰国の日、または招聘した海外の研究者・技術者の日本からの帰国の日から 2 ヶ月以内に、所定の報告書を必ず提出しなければなりません。

7. 成果の公表

本助成により得た成果を文書等で公表の際は、本財団から助成があった旨必ず付言し、その旨記載した印刷物を必ず 1 部、速やかに本財団宛提出してください。

本財団のホームページ等で報告の概略を実績情報として公開します。

8. 申請書の提出期間（期限）

2023 年 10 月 1 日から同年 11 月 15 日までの 1.5 ヶ月間

上記期間外の受付は致しませんので、期限を厳守してください。

9. 申請書の提出先

〒163-1388

東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 4 3 階
一般財団法人電子回路基板技術振興財団
事務局

10. 問合せ先

一般財団法人電子回路基板技術振興財団
事務局

Tel : 080-3569-2511

E-mail : jimukyoku@ecb-zaidan.or.jp

URL : <http://www.ecb-zaidan.or.jp>

以上